



Fully Automatic Grinder DFG8640

追求多様化加工材料の高精确度研磨

实现高精确度研磨

由于部分功率元件或感测元件研磨后所产生的厚度偏差（不同晶圆间的偏差，单片晶圆内的偏差）将对制品特性产生影响，致力于追求高精确度的研磨。DFG8640由加工点配置的更佳化以及各种机械构造的搭载实现高精确度的研磨。

适用于最大Φ8寸的各种材料

采用2主轴，3工作台/1旋转台构造的全自动研磨机。适用于Φ8寸以下的Si（矽），LiTaO3（LT/碳酸锂），LiNbO3（LN/铌酸锂）、SiC（碳化矽）等多种晶圆。



搭载高精确度研磨用的机械构造

为了实现高精确度且高品质的加工，新开发了高刚性·低振动且回转速度变动小的主轴。工作台轴也同样搭载高刚性·低振动·低热膨胀且回转速度变动小的空气轴承组件

提升操作便利性

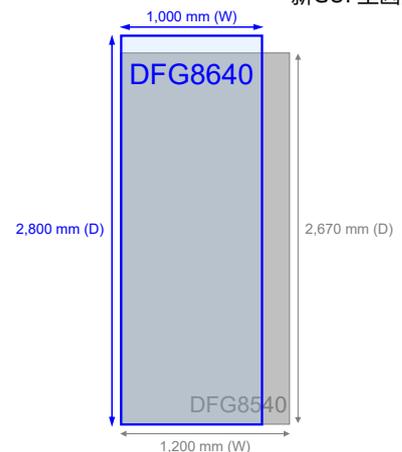
搭载新GUI（圆形化使用者界面），可使用同等于智慧型手机或平板装置的触控·滑动等直觉性操作。也可不受页面阶层限制，快速从任意页面进入目的页面。

提高单位面积生产力

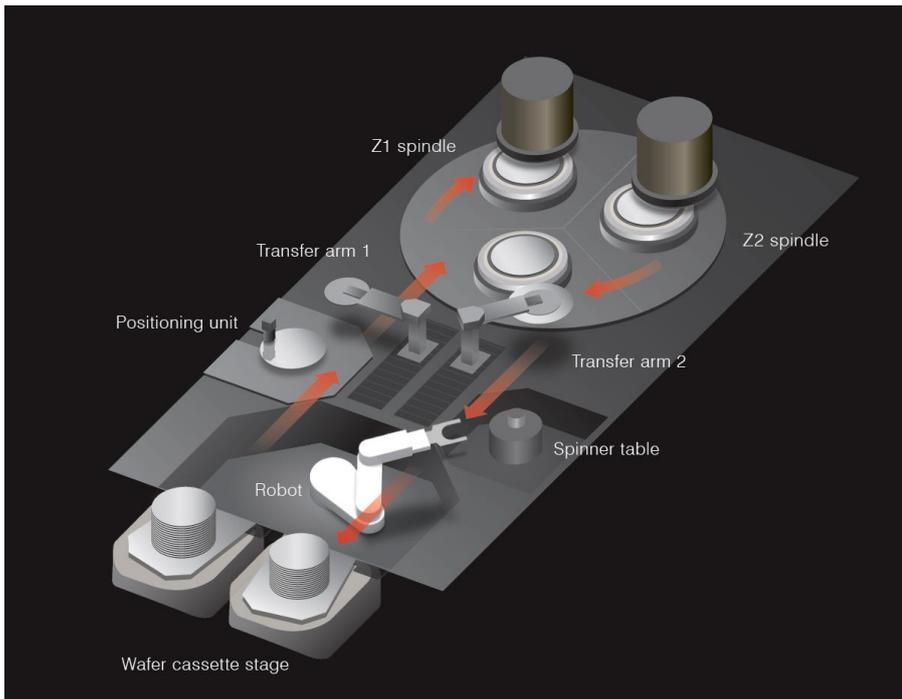
与DFG8540相比约减少了13%的占地面积。此外，由清洗机构动作时间的缩短以及搬运臂动作的调整，达成了与DFG8540相比单位时间1.2倍以上的搬运片数。



新GUI主画面



Fully Automatic Grinder DFG8640



- [1] The robot pick removes the workpiece from the cassette and places it on the positioning table, where centering takes place.
- [2] Transfer arm 1 positions the workpiece on the chuck table.
- [3] The workpieces are ground at Z1 and Z2.
- [4] Transfer arm 2 removes the workpiece from the chuck table and positions it on the spinner table.
- [5] Cleaning and drying
- [6] The robot pick returns the workpiece to the cassette.

Specifications			
Specification		Unit	DFG8640
Wafer diameter		-	ø8"
Grinding method		-	In-feed grinding with wafer rotation
Grinding wheel		mm	ø8"
Spindle	Rated output	kW	6
	Revolution speed	min-1	1,000 – 7,000
Machine dimensions (W x D x H)		mm	1,000 x 2,800 x 1,800
Machine weight		kg	3,500

■使用条件

- 请使用大气压露点在-10~-20℃之间，残余油分为0.1 ppm，过滤度为0.01 μm/99.5%以上的清洁压缩空气。
- 请将机械设备所在空间的室温设定在20℃~25℃之间，并将波动范围控制在±1以内。
- 请将切削水的水温控制为室温+2℃（波动范围在±1℃以内），并将冷却水的水温控制为与室温相同（波动幅度在±1℃以内）。
- 此外，请避免设备受到撞击以及有感振动等的外部振动。请不要将设备设置于风扇，通风口以及易于产生高热或油污等的装置附近。
- 本设备将使用水。为了防范漏水造成的影响，请将设备设置于备有防水地板以及排水处理的场所。
- ※ 基于设备改善考量，本公司可能在不通知用户的情况下变更本规格。因此，请详加确认后再发出订单。
- ※ 压力皆以压力表指示压力值表示。
- ※ 关于本设备的应用技术等咨询，请与本公司销售部门联络。